

证券代码：002008

证券简称：大族激光

## 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023013

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中融基金（11月21日） 中信证券策略会（11月22日） 财通证券策略会（11月23日） 中信证券（11月24日） 德邦证券（11月28日） 申万菱信基金（11月29日） 万家基金（11月30日） 兴业证券（12月1日） 安信证券策略会（12月7日） 天风证券策略会（12月8日）
<b>时间</b>	2023年11月21日-2023年12月8日
<b>地点</b>	广州香格里拉酒店 杭州中科久泰饭店 上海浦东香格里拉酒店 深圳福田香格里拉酒店 公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚 证券事务代表王琳 投资者关系代表胡志毅

投资者关系活动  
主要内容介绍

**一、公司当下经营情况及改善措施**

公司聚焦于智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售，下游行业涉及消费电子、PCB、锂电、光伏、半导体等多个行业，业绩下滑的主要原因为宏观经济下行、行业周期变动等复杂因素影响下，下游客户投资趋于谨慎。面对愈加激烈的市场竞争环境，公司一方面重新调整组织架构，以产品线或项目中心为独立的业务单元，对其独立进行考核管理，逐步提升管理和考核的科学性以及效率性；另一方面，持续推进数字化转型，努力实现智能化制造、数字化管理和可持续发展，提高生产效率和质量，降低成本，增强竞争力。

**二、公司 2023 年三季度经营情况**

公司 2023 年三季度实现营业收入 330,057.57 万元，归属于母公司的净利润 20,873.30 万元，扣除非经常性损益后净利润 16,933.90 万元，分别较上年同期下降 11.12%、37.59%、55.15%。报告期内公司经营业绩较上年同期有所下降，主要原因为宏观经济下行、行业周期变动等复杂因素影响下，下游客户投资趋于谨慎，公司订单有所下降；公司在光伏行业、动力电池行业等新能源行业加大资源投入力度，在半导体行业与核心器件等加大研发投入，均使公司人员薪酬支出等支出有所增长。

**三、公司 3D 打印设备的产品情况**

公司生产研发的 3D 设备主要采用光纤激光器作为能量源，配置高精扫描振镜，成熟切片及路径规划软件等，达到高速扫描和生产，安全可靠，稳定高精，能够适用于不锈钢，铝、钛合金，模具钢等材料打印。

**四、公司为 MR（Mixed Reality）提供的设备情况**

公司持续配合行业重要客户进行 MR 相关加工设备的研发，产品目前已实现批量销售。

**五、通用工业激光加工设备市场复苏情况**

今年以来，通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设备

需求有所复苏。公司进一步调整市场策略，持续加大对中低端市场的覆盖和拓展，整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，提升盈利能力。公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上取得突破，并在钢结构、船舶等重点行业实现突破，与行业头部客户形成紧密合作。公司持续加强和新能源汽车客户的合作，中标比亚迪汽车 31 条白车身顶盖激光钎焊及底盘车架、高强钢电池托盘自动焊接线等多个项目。

#### **六、新能源领域的业务布局**

公司在新能源领域主要提供动力电池以及光伏行业专用的设备，锂电设备产品包括匀浆、搅拌、涂布、辊压、模切、分切、卷绕/叠片、电芯组装、烘烤、注液、化成分容等加工设备及自动化生产线，用于锂电池电芯、模组、PACK 段的生产加工环节。光伏行业专用设备包括激光硼掺杂设备、PECVD（等离子增强气相沉积设备）、LPCVD（低压化学气相沉积设备）、扩散炉、氧化炉、退火炉，以及组件段的无损划片机、划焊一体机等。

此外，公司还和国外多家知名新能源配套厂商及国内头部新能源车企有良好合作关系，提供了汽车白车身智能焊装线、激光焊接设备、电驱智能装配线等产品，国内客户包括比亚迪、长城汽车、大众、宇通等车企。

#### **七、半导体设备（含泛半导体）新产品进展**

在 Micro-LED 领域，公司同步推进在 MIP、COB 封装路线的布局，已经研发出 Micro-LED 巨量转移、Micro-LED 巨量焊接、Micro-LED 修复等设备，市场验证反映良好。第三代半导体技术方面，公司研发的碳化硅激光切片设备正在持续推进与行业龙头客户的合作，为规模化生产做准备，并推出了碳化硅激光退火设备新产品。

#### **八、公司可转债情况**

根据公司 2023 年 10 月 24 日披露的《关于不向下修正大族转债转

	股价格的公告》(公告编号: 2023074), 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 2 月 6 日(“大族转债”到期日), 公司不会提出向下修正转股价格方案, 如再次触及可转债的转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。
附件清单(如有)	
日期	2023 年 12 月 8 日